

证券代码：688620 证券简称：安凯微

## 广州安凯微电子股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2025-IR-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	华西证券、沃华投资、沐德资产、灏达投资、欧锋科技、泽恩投资、牧鑫资产
时间	2025年03月03日至03月07日
地点	广州安凯微电子H大厦
上市公司参会人员姓名	1、副总经理、董事会秘书 李瑾懿 2、证券事务部 葛淳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、投资者了解公司发展历程、主营业务、技术、产品、市场经营、发展战略等情况。</p> <p>二、投资者提出的问题与公司的回复情况。</p> <p><b>Q1：公司在 AI 方面的发展规划？</b></p> <p><b>A1：</b>随着 AI+场景应用需求的驱使及端侧智能化终端市场的迅速发展，作为专注于为物联网智能硬件提供核心 SoC 芯片的公司，公司主要从三个维度去考虑：（1）推进各产品线布局逐步向搭载轻量级或较高智能算力芯片的方向发展，实现端侧芯片的智能化处理能力。自 2022 年推出首代轻量级算力芯片以来，公司带轻量级算力的芯片累计出货量已几千万颗。（2）开发基于大语言模型（LLM）和大视觉模型（LVM）技术的本地化、场景化中小模型，在端侧或者边缘侧落地。（3）与云端大模型做好对接。通过云边端结合满足客户或用户对于终</p>

端智能化的差异化需求和要求。

**Q2: AI 终端应用的进展?**

A2: AK39 系列芯片已实现与大模型底座的对接, 例如合作伙伴 2025 年 1 月推出的“天才虎 AI 智能录音笔”, 对接了多家大语言模型。目前市面上也已经有基于公司芯片并支持大模型的摄像机类终端产品在售。后续公司会推动所有主流芯片完成与大模型的适配和接入。预计会有越来越多的终端应用陆续推向市场。届时我们会以恰当的方式向投资者披露相关信息。

**Q3: 物联网应用处理器芯片大部分用在什么领域? 公司芯片可以应用的终端产品很多, 类别比较分散, 如此, 需要为每一个场景都开一颗芯片吗? 介绍一下智能门锁业务。**

A3: 公司物联网应用处理器芯片的下游市场非常广阔, 针对广泛的 IoT 终端, 但是并非每一个场景需要专门开发不同的芯片。应用处理器芯片特点之一就是单颗芯片可以支持多种功能, 可以根据具体场景的需要, 基于同一芯片开发不同的系统软硬件及应用。除了不断推出新的芯片产品, 公司也持续在通过这种方式拓宽各类芯片产品的在新的领域应用, 如智能零售终端、智能耳机等等。

关于智能锁业务, 随着终端用户对智能门锁的功能需求增多, 传统的采用 MCU 方案已经不能完全满足用户差异化和性能要求, 采用 SoC 方案的终端产品逐渐被市场青睐。目前市场上的智能门锁包含全自动、半自动两大类, 每大类具有指纹识别、人脸识别、掌纹识别、掌静脉识别、密码、刷卡、可视对讲等部分或者全部功能和开锁方式。公司芯片产品和解决方案可以支持上述所有智能锁品类的产品需求, 并为下游客户提供“全栈式、工业级”解决方案。客户可以根据实际项目和功能需求采购一颗或者多颗安凯微的芯片, 也可以采购基于公司芯片的智能锁模组或者套料产品, 产品化更便利。至今公司多个智能锁新项目已经实现量产。

**Q4: 公司的竞争优势是什么?**

A4: 公司的优势体现在以下几个方面:

1、拥有众多高度可控的 IP 和多年沉淀积累的核心技术, 使得公司可以根据下游客户和应用领域差异化需求进行产品的快速设计开发, 满足 AIoT 市场多样化的需求。公司掌握音频、视频、语音、图像、图形等多媒体技术, BLE 等短距离通信联接技术, 机器学习以及 SoC 系统技术等技术, 有能力依托芯片产品, 为客户打造涵盖音频、视频、语音、图像、图形等全方位多媒体体验, 从芯片层面为用户实

现从多媒体到多模态体验的跨越，提供综合性技术支撑。同时，丰富的知识产权储备，形成了完善的知识产权体系，为公司在市场竞争中提供了法律保障和技术壁垒。

2、经过二十多年及多个系列芯片量产的实战经验，形成了全面、高水平的芯片设计能力。主要体现在公司新芯片设计项目的流片成功率(公司近 4 款全光罩流片项目中,3 款均实现了“一次流片即量产”)。

3、产品系列相对完善，产品性能具有竞争力，关键技术指标领先。如：物联网摄像机芯片已经覆盖了从 100 万像素分辨率到 8K 分辨率的产品，截至 2024 年发布的孔明二代芯片，目前 4K 分辨率芯片已经量产，8K 芯片在研中。智能化方面，公司已经拥有带有轻量级算力芯片，且带有较高算力的芯片已经流片，带有更高算力的芯片在研。公司已有分别支持视觉、音频、蓝牙、人机交互等的多类芯片量产，芯片性能优越，且在性能、晶粒面积、功耗三个方面（简称“PPA”）得到了良好的平衡。公司芯片与行业主流产品整体性能相当，其中芯片在 ISP 处理能力、智能算力、CIS 接口、典型工作功耗方面具有优势。

4、公司打造了一支经验丰富、具有创造力的研发团队，涉及 20 多个专业学科，骨干人员多毕业于著名高校，核心技术人员更是有着扎实研发和技术功底的专家级技术人才，内部还设有博士后创新实践基地；同时，建立了（或拟建）高性能芯片设计与验证实验室、FPGA 实验室、ISP 实验室、音频电声实验室、静电释放实验室、电磁干扰实验室、射频屏蔽室、环境实验室、硬件实验室、SMT 贴片实验室等多个芯片设计相关的实验室，提升公司综合研发能力。

5、具有丰富稳定的客户资源。经过多年的技术积累和市场验证，公司芯片产品获得市场的广泛认可，芯片已经进入 ROKU、国内三大运营商、TP-LINK、涂鸦智能、摩托罗拉、熵基科技、安居宝、厦门立林、宁波得力、福州冠林、德施曼、凯迪仕、浙江公牛等众多知名终端品牌。随着公司产品系列的不断丰富，与客户的粘性也日益增强，有利于进一步客户渗透和新产品的开拓。

6、技术支持服务稳定可靠。芯片设计公司除了提供下游企业产品外，还提供下游客户完整的产品开发包、开发辅助工具和技术服务支持。

7、供应链合作稳定，有利于产品品质保证。公司已经与知名晶圆制造和封装测试厂商建立了长期稳定的合作关系，积累了丰富的供应链管理经验和丰富的供应链管理经验。此外，公司采用“Fabless+芯片终测”模式，搭建了芯片终测车间，通过自主设计和定制的自动化测试设备与测试流程，提升

	<p>了芯片测试效率，进一步保障公司产品质量。</p> <p><b>Q5：公司每年的项目建设费用和研发投入都很大吧？</b></p> <p><b>A5：</b>作为一家创新驱动的企业，公司注重长期可持续发展，坚持持续的研发投入，资源聚焦技术发展趋势，以不断推出有竞争力的产品，巩固市场地位和开拓更多的业务。市场竞争加剧叠加研发投入刚性增长都使业绩短期承压，公司会通过技术创新持续推出有竞争力的产品，拓展开新的市场和客户，并结合持续的供应链降本等手段以应对当前的压力。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次交流活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。
日期	2025年03月07日
会议记录人：葛淳 填表人：葛淳 填表日期：2025-03-07	